



平成26年9月5日

各位

会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代表者 執行役社長 久田 眞佐男
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
コード番号 8036 (東証第一部)
問い合わせ先 CSR・コーポレートコミュニケーション部長
横井 芳人 (電話:03-3504-5138)

当社一部事業の撤退に関するお知らせ

株式会社日立ハイテクノロジーズ (以下、日立ハイテク) は、本日開催の取締役会において、電子デバイスシステムセグメントに含まれるチップマウンタ事業から撤退することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 事業撤退の理由

日立ハイテクグループでは平成15年より、日立ハイテク100%子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツ (以下、日立ハイテクインスツルメンツ) で、チップマウンタ装置および周辺装置の開発・製造・サービスを担当し、日立ハイテクが販売を担当して、チップマウンタ事業の事業基盤強化や製品競争力向上を図ってまいりました。

しかしながら、パソコンやデジタル家電市場の低迷、ハイエンドモバイル市場の成長鈍化の影響を受け、当該事業における事業環境は厳しい状況が続いております。当該事業につきましては、これまでも継続した事業構造改革を実施してまいりましたが、業績改善を図ることは難しいと判断し、当該事業からの撤退を決定いたしました。

2. 撤退する事業の概要

(1) チップマウンタ事業

①日立ハイテク：チップマウンタ装置および周辺装置の販売

②日立ハイテクインスツルメンツ：チップマウンタ装置および周辺装置の開発・製造およびサービス

(2) チップマウンタ事業の売上高 (平成26年3月期実績)

	チップマウンタ事業(a)	連結売上高(b)	比率(a/b)
売上高	68億円	6,391億円	1.1%

3. 今後の予定

平成27年3月末の撤退完了を目処とします。なお、当該事業の資産につきましては、ヤマハ発動機株式会社 (代表取締役社長：柳 弘之) との間で平成27年2月1日をもって一部の資産を譲渡することを目的とした資産譲渡等の契約を本日締結いたしました。また製品のサービス業務につきましては、ヤマハ発動機株式会社と協力して実施してまいります。

4. 業績への影響

当該事業からの撤退による業績への影響につきましては現在精査中であり、業績に大きな影響を与えることが見込まれる場合には、確定しだい速やかにお知らせいたします。

以上